附表二

公司概況資料表

以下資料由鑫詮科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

- 認購相關資訊
- 公司簡介
- 主要業務項目
- 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
- 最近五年度簡明資產負債表
- 最近三年度財務比率

公司名稱：鑫詮科技股份有限公司 (股票代號：7954)

董事長	陳慧萍
總經理	盤振詮
資本額	新臺幣211,500,000元
輔導推薦證券商	永豐金證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	永豐金證券股份有限公司 羅小姐(02)2382-5510
註冊地國	本公司非屬外國發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	本公司非屬外國發行人，故不適用

修訂日期：114年12月

輔導推薦證券商認購鑫詮科技股份有限公司股票之相關資訊		
證券商名稱	主辦	協辦
	永豐金證券股份有限公司	第一金證券股份有限公司
認購日期(註)	115年10月14日	
認購股數（股）(註)	535,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率(註)	2.53%	0.47%
認購價格(註)	每股新臺幣61元	
申請或登錄興櫃前三個月認購之總股數及占擬櫃檯買賣股份總數之比率（證券商認購創櫃板階段之新股且計入興櫃應認購股份者適用）	該公司未登錄創櫃板，故不適用。	
認購價格之訂定依據及方式	1.認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式 本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等評價方式，以推算合理之認購價格，作為本推薦證券商認購鑫詮科技股份有限公司(以下簡稱鑫詮科技公司或該公司)興櫃股票價格之訂定依據；再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。 2.與適用國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較 由於股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，使評估之結果亦有所差異。茲將上述證券投資分析常用之股票評價方法列示如下： (1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。 (2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。 (3)現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF)：係根據該公司未來預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值。 以上股票評價方法中，由於成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法則須推估某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握。	

鑫詮科技公司主要從事半導體機器設備與自動化機器設備領域的高階 OEM/ODM 製造業務，核心專長涵蓋客製化的自動化設備開發、專注應用於 AI 晶片高階測試的精密低溫溫控系統。經參考與鑫詮科技公司從事相同或類似業務或身處同產業之國內上市及上櫃公司，選擇上市公司鴻勁精密股份有限公司(以下簡稱鴻勁，股票代號：7769)、上櫃公司萬潤科技股份有限公司(以下簡稱萬潤，股票代號：6187)及上市公司志聖工業股份有限公司(以下簡稱志聖，股票代號：2467)作為該公司之採樣同業。

鴻勁主要係從事提供 IC 測試分選機及其相關設備整合性解決方案，並擁有高精度之溫控技術，聚焦高階半導體測試領域之應用；萬潤係專業自動化機器設備製造商，主要係從事半導體、被動元件、LED 製程自動化機械工程設計、加工、製造組立及電腦軟體設計開發之專業科技公司；志聖主要係從事 AI 供應鏈用印刷電路製程設備(包含貼膜、撕膜、熱製程與電鍍前處理等)、AI 供應鏈用先進封裝設備(包含貼膜、壓合、撕膜、熱製程、清潔處理等)及其他電子應用製程設備；上述公司主要皆從事與半導體/自動化機器設備相關業務，故選擇其作為該公司之採樣同業。

茲將上述採樣同業公司及上市櫃半導體類股之最近三個月(115年6月~8月)之本益比及股價淨值比列示說明如下：

本益比

單位：倍

月份 採樣同業	115年6月	115年7月	115年8月	115年6~8月平均
7769鴻勁	87.70	79.07	70.04	78.94
6187萬潤	72.83	65.91	67.04	68.59
2467志聖	77.75	74.14	57.96	69.95
上市-半導體類	36.44	33.77	29.32	33.18
上櫃-半導體類	50.86	39.51	30.85	40.41

資料來源：證券交易所及證券櫃檯買賣中心網站資料。

股價淨值比

單位：倍

月份 採樣同業	115年6月	115年7月	115年8月	115年6~8月平均
7769鴻勁	20.16	18.18	19.74	19.36
6187萬潤	15.57	14.10	14.67	14.78
2467志聖	10.97	10.46	6.32	9.25
上市-半導體類	9.86	9.25	8.62	9.24
上櫃-半導體類	6.94	5.51	5.70	6.05

資料來源：證券交易所及證券櫃檯買賣中心網站資料。

參考該公司採樣同業、上市及上櫃半導體類股最近三個月(115年6~8月)之平均本益比區間為33.18倍~78.94倍，另經參閱該公司114年度及115年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報

	告，依據該公司最近四季(114年第二季~115年第二季)之稅後淨利為13,966千元，以預計登錄興櫃掛牌股數21,150千股計算，每股稅後盈餘為0.66元，依前開本益比區間設算每股參考價格區間為21.90元~52.10元。 然隨著該公司營運規模及業務逐漸擴張，該公司於115年上半年度辦理盈餘轉增資及現金增資，股本由114年底的8,700千股快速增加至115年6月底的17,650 千股，以及認列一次性之現金增資員工認股酬勞成本，使得營業成本及營業費用合計增加26,160千元，致115年上半年度稅後淨利受一次性之現金增資員工認股酬勞成本認列及股本擴張影響甚鉅，若逕採本益比法作為主要評價依據，恐未能合理反映該公司現有之營運績效及企業價值，故本益比法僅列為輔助參考。 另參考該公司採樣同業、上市及上櫃半導體類股最近三個月(115年6~8月)之平均股價淨值區間為6.05倍~19.36倍，惟鴻勁因與採樣同業之類股偏離過高，故不予採納設算，排除極端值後其他採樣同業之平均股價淨值區間為6.05倍~14.78倍；另經參閱該公司115年第二季經會計師核閱之財務報告，該公司115年6月30日經會計師核閱之股東權益為234,108千元、實收股本為17,650千股，每股淨值為13.26元，依前開股價淨值比法設算每股合理參考價格區間為80.22元~195.98元；考量興櫃市場之流動性風險貼水，並以七折設算後，每股參考價格區間為56.16元~137.19元。 綜上，考量該公司115年上半年度稅後淨利受一次性之現金增資員工認股酬勞成本認列及股本擴張因素影響，本益比法不宜作為本次認購價格之主要依據；另參酌股價淨值比法設算結果、該公司經營績效、獲利情形、所屬產業特性、產業未來成長性、同業市場評價狀況，以及該公司最近一次現金增資每股認股價格60元，本輔導推薦證券商與該公司共同議定興櫃主辦及協辦輔導證券商之每股認購價格為61元，介於每股合理價格區間內，故認購價格尚屬合理。

註：輔導推薦證券商認購公司登錄創櫃板期間發行之新股，且計入其於興櫃應認購股份者，應依序敘明每次認購日期及其認購股數、認購價格。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

鑫詮科技股份有限公司(以下簡稱鑫詮科技公司)設立於民國98年12月7日，目前主要從事半導體設備與自動化設備領域的高階 OEM/ODM 製造，核心專長涵蓋客製化的自動化設備開發、專注應用於 AI 晶片高階測試的精密低溫溫控系統。截至115年8月底止，實收資本額為新臺幣211,500千元。

鑫詮科技公司主要競爭優勢有(1)與台灣知名半導體設備大廠的合作關係；(2)專業的工程技術服務經驗與實績；(3)擁有配合客戶發展之研究開發團隊；(4)與客戶建立長期緊密夥伴關係。

二、歷史沿革

年度	月份	重　要　紀　事
民國98年	12月	公司成立，中文名稱為鑫詮科技有限公司，登記資本額貳拾伍萬元；實收資本額貳拾伍萬元。
民國102年	3月	現金增資，登記資本額伍佰萬元；實收資本額伍佰萬元。
民國108年	5月	現金增資，登記資本額貳千捌佰萬元；實收資本額貳千捌佰萬元。
民國113年	4月	現金增資，登記資本額伍千萬元；實收資本額伍千萬元。
民國113年	12月	改制為股份有限公司。
民國114年	10月	現金增資，登記資本額捌千萬元；實收資本額捌千萬元。
民國115年	1月	盈餘轉增資，登記資本額捌千柒佰萬元；實收資本額捌千柒佰萬元。
民國115年	2月	現金增資，登記資本額壹億柒佰萬元；實收資本額壹億柒佰萬元。
民國115年	4月	盈餘轉增資，登記資本額壹拾億元；實收資本額壹億叁千肆佰伍拾萬元。
民國115年	5月	現金增資，登記資本額壹拾億元；實收資本額壹億柒千陸佰伍拾萬元。
民國115年	8月	現金增資，登記資本額壹拾億元；實收資本額貳億壹千壹佰伍拾萬元。

三、經營理念

鑫詮科技公司秉持技術創新、誠信經營及專業服務的精神，透過鑫詮科技公司所建構的專業服務平台、豐富的流程管理經驗及品質要求，提供與時俱進/專業/可靠/穩定的製造與技術服務，以此創造合作夥伴、客戶和鑫詮科技公司的三贏成果，成為企業最值得信賴的夥伴。

四、未來展望

1.短期發展計畫

(1)積極拓展台灣市場，增加客戶群

目前鑫詮科技公司營業內容涵蓋半導體封測設備、PCB 及各式自動化設備等，未來預計持續投入研發新設備以擴大營業項目，及提高公司品牌能見度。

(2)提升品質，掌握市場需求

提高產品品質及服務，建立完善品保制度及規範，提升客戶之信賴度，製造雙贏合作。

修訂日期：114年12月

(3)優化客製化生產流程

依照不同客製化需求，採用模組化生產加速生產流程，用最短時間完成最多樣產品。除了強化生產的核心競爭力外，也提高客戶對公司的依賴度。

2.長期業務發展計畫

(1)爭取與國內外大廠合作

鑫詮科技公司將積極爭取與更多的半導體廠商的合作機會，成為生產半導體設備及工廠智能自動化優質廠商。

(2)掌握產業動態，靈活創新配合客戶需求

依照各產業的特性，憑藉多年協助各產業設備組裝及維修經驗之優勢，隨時掌握產業動態，配合客戶需求開發各類型創新設備。

(3)自有產品之推廣

不同於前兩項之業務進行方式，需要進行充分的市場調查、競爭分析、與客戶關係經營，故除了持續的產品研究開發外，布建足夠的業務能量，逐步擴大市場之滲透率，提供服務客戶之設備周邊之軟、硬體之整合與改良等業務，提供完整的技術支援和客製化整合服務，提升客戶滿意度。

(4)自有產品之跨領域應用及拓展海外市場

鑫詮科技公司自有研發產品主要圍繞在半導體設備生產，有關於工廠自動化、智能化與遠端控制的需求也多半來自於半導體產業。其他產業人力替代的需求規劃也是逐漸提高中，工廠自動化、智能化與遠端控制的需求具有長期開發潛力，故透過跨領域應用之業務開發，公司可以分散風險，增加新的業務機會。此外，隨著半導體產業之區域化分散化之趨勢，未來擬透過鑫詮科技公司設立之轉投資公司、代理商，或鑫詮科技公司主要客戶之海外工廠需求等，來推展海外之市場。

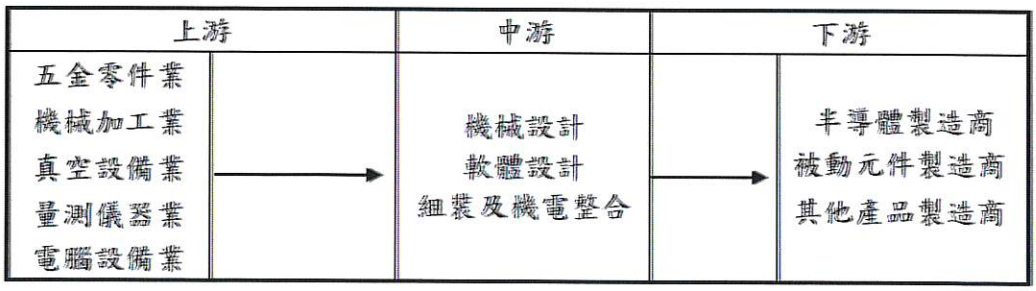
TOP

主要業務項目：

主要從事半導體設備與自動化設備領域的高階 OEM/ODM 製造，核心專長涵蓋客製化的自動化設備開發、專注應用於 AI 晶片高階測試的精密低溫溫控系統。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

鑫詮科技公司主要產品為檢量測 AOI、CPO 等先進半導體封裝設備、低溫冷凍檢測設備。鑫詮科技公司生產所需之大部分零組件係向協力廠商採購，在取得零組件後負責研發、設計組裝及檢測後銷售予下游半導體、PCB 等製造廠商，以供其生產、封裝測試使用，故屬於該產業之中游。茲將鑫詮科技公司所從事之半導體/自動化製程設備所屬產業之上、中、下游之關聯架構圖列示如下：



修訂日期：114年12月

A.上游－高精密關鍵零件等材料供應：

鑫詮科技公司深耕高階半導體與自動化設備領域，製程需採購多項高精密關鍵零組件，包括配電盤、自動化控制器(PLC/PC-Based)、精密機殼、機械臂、閥體與各類精密機構模組。上述零組件之品質、穩定性與供應交期，將直接影響鑫詮科技公司機台之製造效率、系統可靠度與量產交付能力。在製程材料與客戶端應用方面，隨著 AI/HPC 高效能運算晶片的爆發，高階晶片在高速運算與測試時會產生極高的熱能耗散。此外，在 PCB 與 IC 載板領域，由於線路極細且價格昂貴，材料的熱膨脹係數與應力表現至關重要。晶片與載板在經歷極端物理拉扯或高速測試時，對於極低溫控制、防靜電、低震動與精準對位 具有極苛刻的標準。鑫詮科技公司之技術參數設定與製程窗口，正是為了確保終端產品在極端環境下的封裝效果與良率穩定性。

B.中游－設備研發、自主技術與高階 OEM/ODM 製造服務：

鑫詮科技公司定位於半導體與自動化設備產業鏈中游，主要從事半導體高階溫控設備、半導體測試與 AOI 外觀檢測模組代工、以及 PCB/IC 載板自動化上下料設備之研發、製造與銷售。深耕半導體先進封裝測試與高階載板自動化兩大核心應用領域，茲說明如下：

a.半導體先進封裝測試領域：鑫詮科技公司具備深厚的半導體高階測試設備與精密低溫溫控系統之製造實力。針對先進封裝因 AI 晶片算力躍升所帶來的極端熱耗散，同時能提供及量產效能卓越可滿足客戶所需不同低溫下穩定測試的需求。

b.PCB / IC 載板領域：鑫詮科技公司致力於推動高效自動化導入，利用客製化雷射鑽孔機周邊上下料設備，協助客戶降低對傳統高密度人工的依賴。此類自動化設備可支援 ABF 載板等高密度的精密金屬化製程需求，強調低震動與精準對位，確保上下料過程不造成物理損傷，進一步強化客戶於高階載板應用之核心競爭力。

C.下游－全球產業生態系與強大終端應用：

鑫詮科技公司下游客戶群涵蓋全球半導體、IC 載板及高階 PCB 產業之領導廠商。在半導體領域，客戶包含整合元件製造商、晶圓代工廠及專業封裝測試廠，終端應用涵蓋高效能運算、AI 晶片、車用電子、低軌衛星通訊及高速網通設備等高成長市場。

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
半導體相關設備生產與加工		提供低溫冷凍系統、半導體測試機台及其週邊設備之專業技術服務。針對客戶不同製程規格需求，提供客製化開發、系統組裝與測試驗證服務，以協助客戶達成生產設備運轉效益最佳化。	162,401	78.98%
PCB 相關設備生產與加工		提供 PCB 相關機器設備(如:PCB 自動上下料設備及自動化精密檢測儀器)，針對客戶不同製程規格需求，提供客製化開發、系統組裝與測試驗證服務，以協助客戶達成生產設備運轉效益最佳化。	15,000	7.30%
其他	—	半導體相關零組件(如:電控配盤、面板治具、鋁擠等)。	28,216	13.72%
合　計			205,617	100.00%

修訂日期：114年12月

TOP

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度		110年度(註1)	111年度(註1)	112年度(註1)	113年度(註2)	114年度(註2)	115年截至8月份止(自結數)(註3)
營業收入		24,909	39,764	77,672	82,249	205,617	295,538
營業毛利		5,990	9,551	15,954	21,542	60,275	56,395
毛利率(%)		24.05	24.02	20.54	26.19	29.31	19.08
營業損益		1,770	2,517	1,835	10,645	40,723	20,487
營業外收入		1	12	3,133	4,461	3,617	2,661
營業外支出		(987)	(2,038)	(3,167)	(4,399)	(5,728)	(4,682)
稅前損益		784	491	1,801	10,707	38,612	18,466
稅後損益		627	393	1,441	8,085	31,232	14,794
每股盈餘（元）		0.22	0.14	0.51	1.63	4.95	0.70
發放	現金股利(元)	註4	註4	註4	0.03	0.06	—
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	—	—	—	—	—	—
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	—	—	—	0.88	2.57	—

註1：上列110~112年度財務數字係依照商業會計法編製，並經會計師查核簽證。

註2：上列113~114年度財務數字係依照國際財務報導準則編製，並經會計師查核簽證。

註3：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

註4：鑫詮科技公司於98年12月7日設立時之公司型態為「有限公司」，並於113年12月31日完成變更登記為「股份有限公司」。因此，該公司於110~112年度之盈餘分配(現金股利或股票股利)係以股利總金額表達；自113年度起，則依「股份有限公司」之形式揭露每股現金股利或每股股票股利。該公司110~112年度盈餘分配之現金股利總金額分別為565千元、354千元及1,297千元。

修訂日期：114年12月

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度		110年底 (註1)	111年底 (註1)	112年底 (註2)	113年底 (註2)	114年底 (註2)
流動資產		13,028	8,647	16,791	67,116	152,641
基金及長期投資		—	—	—	—	—
固定資產		104,890	212,437	161,797	174,238	180,949
無形資產		—	—	—	1,868	2,011
其他資產		—	219	74,155	74,100	79,182
資產總額		117,918	221,303	252,743	317,322	414,783
流動負債	分配前	15,125	35,372	60,362	108,231	152,407
	分配後	15,690	35,726	61,659	108,507	153,016
長期負債		73,812	157,122	162,485	150,407	142,736
其他負債		—	—	—	—	—
負債總額	分配前	88,937	192,494	222,847	258,638	295,143
	分配後	89,502	192,848	224,144	258,914	295,752
股本		28,000	28,000	28,000	50,000	87,000
資本公積		—	—	—	—	—
保留盈餘	分配前	981	809	1,896	8,684	32,640
	分配後	416	455	599	8,408	32,031
長期股權投資未實現跌價損失		—	—	—	—	—
累積換算調整數		—	—	—	—	—
股東權益總額	分配前	28,981	28,809	29,896	58,684	119,640
	分配後	28,416	28,455	28,599	58,408	119,031

註1：上列110~111年度財務數字係依照商業會計法編製，並經會計師查核簽證。

註2：上列113~114年度財務數字係依照國際財務報導準則編製，並經會計師查核簽證。112年底之財務數字，係114年度依國際財務報導準則編製且經會計師查核簽證之財務報告所附列之113年1月1日之財務數字。

註3：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

TOP

最近三年度財務比率

項目 \ 年度		112年度 (註1)	113年度 (註1)	114年度 (註1)
財務比率	毛利率(%)	20.54	26.19	29.31
	流動比率(%)	28.66	62.01	100.15
	應收帳款天數(天)	6.88	92.63	88.80
	存貨週轉天數(天)	—(註2)	62.82	116.98
	負債比率(%)	88.06	81.51	71.16

註1：上列112年度財務比率，係依商業會計法編製且經會計師查核簽證之財務報告數字計算。113~114年度財務比率，係以114年度(附列113年度及113年1月1日)依國際財務報導準則編製且經會計師查核簽證之財務報告數字計算。

註2：111年底及112年底之存貨餘額皆為新臺幣0元，故不適用存貨週轉率及存貨週轉天數。

TOP

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!!

修訂日期：114年12月